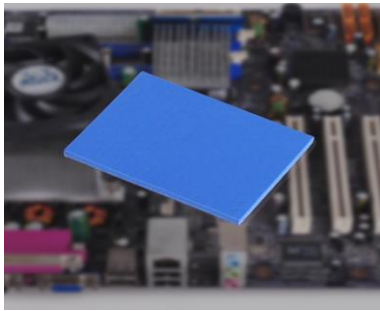


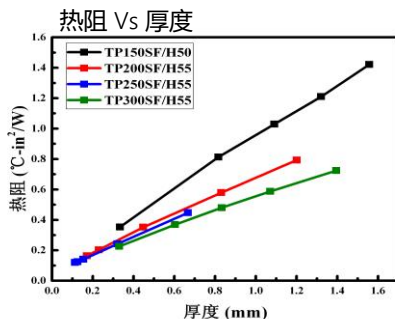
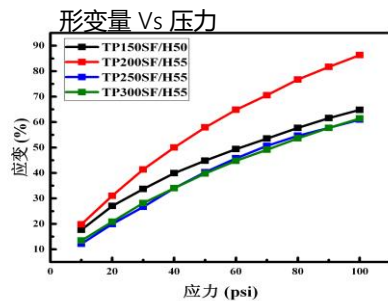
TPxxx-SF 无硅导热垫片系列

特性与优点

- 导热系数: 2.0, 3.0 W/m.K
- 无硅油析出或硅氧烷挥发
- 良好的机械性能
- 强自粘性 · 可单双面去粘
- 高绝缘
- 尺寸稳定 · 耐用性好
- 高压缩



SF 系列无硅导热垫片是专为对有机硅敏感应用而设计、开发的一种高导热、高强度、阻燃的界面导热材料。针对不同的应用场合开发了多个型号，可以满足高压缩、多次重工、抗撕裂、高频振动冲击等多种应用场合。



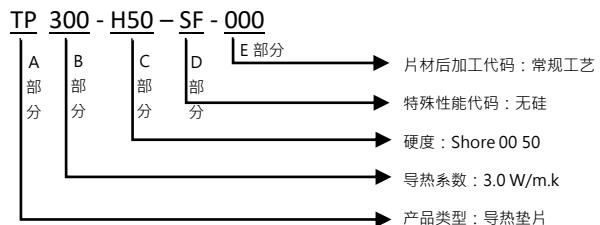
典型属性

属性	标称值		测试方法
产品	TP 200SF	TP 300SF	-
组成部分	丙烯酸酯	丙烯酸酯	-
颜色	绿色	蓝色	Visual
厚度 (mm)	1.0~10.0	1.0~10.0	ASTM D374
密度(g/cc)	2.9	3.3	ASTM D792
硬度 (Shore 00)	45	50	ASTM D2240
耐温范围(°C)	-40~125	-40~125	-
电性能			
击穿电压(Kv/mm)	> 6.0	> 6.0	ASTM D149
防火等级	V-1	V-1	UL 94
热性能			
导热系数(W/m.K)	2.0	3.0	ASTM D5470

典型应用

- 光纤模块
- 医疗设备
- 硬盘驱动器
- 光学精密设备
- 高端工控设备
- 汽车传感器/控制模块
- 有机硅敏感元件/设备/产品

产品编码规则



标准尺寸: 200x400mm. 可依客户指定模切成各种尺寸或形状。厚度按照0.25mm递增。